

证券代码：002916

证券简称：深南电路

深南电路股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2019-015

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（__电话会议__）
参与单位名称及人员姓名	1、 国泰君安珠海策略会（2019年11月1日） 2、 中信建投证券联合调研（2019年11月4日） 3、 花旗银行深圳策略会（2019年11月5日） 4、 公司集体调研（2019年11月5日） 5、 麦格理证券联合调研（2019年11月5日） 6、 瑞信证券深圳策略会（2019年11月6日） 7、 台湾国泰证券电话会议（2019年11月7日） 8、 汇丰前海证券、摩根斯坦利、国信证券联合调研（2019年11月11日） 9、 花旗银行、台湾永丰金证券、建银国际联合调研（2019年11月12日） 10、 华创证券深圳策略会（2019年11月12日） 11、 招商证券北京策略会（2019年11月13-14日） 12、 中金公司联合调研（2019年11月13日） 以上共计407人次。
时间	2019年11月1日-15日
地点	公司南山总部5楼会议室、策略会举办地点
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书：张丽君；证券事务代表：谢丹；投资者关系经理：曾旖。
投资者关系活动主要内容介绍	环节： 问答交流 交流主要内容：

Q1、请简要介绍公司三项业务的基本情况。

公司拥有印制电路板、封装基板及电子装联三项业务，形成了业界独特的“3-In-One”业务布局：即以互联为核心，在不断强化印制电路板业务领先地位的同时，大力发展与其“技术同根”的封装基板业务及“客户同源”的电子装联业务。

公司深耕印制电路板（PCB）行业三十余年，积累了丰厚的技术基础与行业经验。目前公司所生产的 PCB 产品主要面向企业级应用领域，比如通信（主要指无线基站、承载网、核心网等）、工控医疗、航空航天、汽车电子及服务器等。企业级的客户通常对产品稳定性及可靠性要求更高。向产业链上、下游，公司分别拓展了封装基板和电子装联两项业务。其中公司封装基板业务的主要产品有 MEMS-MIC、FP（指纹模块封装基板）、RF（射频模块封装基板）、存储芯片封装基板等，主要面向消费电子领域；公司电子装联业务主要是依据设计方案，为客户将电子元器件通过插装、表面贴装、微组装等方式装焊在 PCB 上，实现电子与电气的互联，为客户提供一站式综合服务。

Q2、请简要介绍公司 2019 年三季度业绩情况。

公司 2019 年三季度单季度营业收入为 28.67 亿元，同比增长 36.69%；2019 年 1-9 月营业收入为 76.58 亿元，同比增长 43.50%。前三季度营业收入的同比增长主要来自于三个方面：通信、服务器等下游领域需求的增加，南通数通一期工厂贡献的新增产能，以及产品结构的调整。净利润方面，公司三季度单季度实现归属于上市公司股东的净利润 3.96 亿元，同比增长 105.81%，2019 年 1-9 月实现归属于上市公司股东的净利润 8.67 亿元，同比增长 83.40%。

Q3、请简要说明公司 2019 年三季度毛利率变化的主要原因。

2019 年三季度，公司单季度毛利率实现较好增长，主要来自于产品结构的调整及公司内部生产运营效率的提升。近几年以来，公司持续通过自动化、信息化改造，打造专业化产线等方式提升内部运营效率，改善毛利率水平。

Q4、公司无锡基板工厂目前进展情况如何？

无锡封装基板工厂系公司 IPO 募投项目“半导体高端高密 IC 载板产品制造项目”投资建设的工厂，主要面向存储类封装基板，于 2019 年 6 月连线试生产，目前处于产能爬坡

状态。封装基板工厂爬坡周期较 PCB 工厂相对较长，通常需要 1-2 年，甚至更长时间，具体需要参考客户认证的进度以及订单情况。目前已有部分客户通过认证。

Q5、公司南通数通二期工厂目前进展情况如何？

南通数通二期工厂系公司可转债募投项目“数通用高速高密度多层印制电路板（二期）投资项目”建设的工厂，主要面向 5G 通信产品、服务器用高速高密度多层印制电路板。该工厂于 2019 年上半年投入建设，如进展顺利，有望于 2020 年中完成建设并投入生产。伴随未来 5G 带来的数据流量增加，数据中心硬件产生的 PCB 相关需求将快速提升，公司也将持续加快建设进度以满足市场需求。

Q6、除以上两个工厂外，公司是否还有新增产能，产能利用率情况如何？

今年以来，公司订单情况良好，各工厂产能利用率整体处于较高水平。除正在产能爬坡的无锡基板工厂和正在建设的南通数通二期 PCB 工厂外，公司暂无大的新增产能，主要着力于对存量产能的改造及挖潜。

Q7、5G 建设高峰期如来临，公司产能供应是否能满足 5G 需求？

目前阶段来看，公司一方面持续开展内部产品结构调整、打造专业化产线，进行自动化、信息化工厂的改造，不断提升存量产能的生产效率和产出能力，同时 5G 相关改造持续在进行；另一方面也着手投资建设新增产能，如南通数通二期项目主要面向 5G 通信产品、服务器用高速高密度多层印制电路板，在产能方面已有一定准备。公司未来也将持续关注市场变化，紧密跟踪客户需求，对产能的供应开展有序规划。

Q8、目前 5G 产品收入的占比情况如何？

今年以来，公司 5G 产品由样品阶段进入小批量阶段，并逐步进入批量阶段，占营收的比重有所提升。未来公司将继续跟进产业建设和客户需求，及时把握市场变化，积极调整产品结构。

Q9、除通信市场外，近几年公司是否还有其他重点发展方向？

就 PCB 业务而言，除通信市场外，公司还持续看好服务器领域及未来汽车电子领域的

发展。就封装基板业务而言，公司看好存储领域封装基板的未来市场发展。前述也将是公司未来几年的重点发展方向之一。

Q10、近期公司采购覆铜板的价格趋势如何？

近一段时间公司覆铜板采购价格总体相对平稳。

Q11、对于覆铜板供应商，是由客户指定还是公司自主选择？

公司在进行原材料采购时，针对生产过程中覆铜板、半固化片等重要原材料，大部分情况下会采取综合评估招标的方式，即综合评估供应商报价、品质、产能、交付、合作历史等因素，自主选择评分最高的供应商。但在部分情况下，客户提供的设计方案已选定材料型号，该情形下将由客户主导供应商的选择。

Q12、5G 产品进入大批量供应阶段后，产品价格是否会发生变化？

根据产品的生命周期，正常情况下在经历样品、小批量、批量的阶段进入大批量生产以后，因为量产的原因，产品价格可能会出现一定程度的变化，具体的变化幅度公司较难进行预测。同时，伴随批量变大，产品生产质量的稳定性、良率等规模效应也通常得以体现。

Q13、2019 年前三季度公司的资本开支主要有哪些？

前三个季度，公司的资本开支主要用于无锡基板工厂和南通数通二期工厂建设，以及各个存量工厂的技术改造（包含 5G 相关改造）。

Q14、公司发行可转债项目的进度如何？

中国证券监督管理委员会（即“中国证监会”）发行审核委员会于 2019 年 10 月 18 日对公司公开发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得通过。目前公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，并将在收到后另行披露。

注：调研过程中公司严格遵照《信息披露管理制度》等规定，未出现未公开重大信息

	泄露等情况。
附件清单	无
日期	2019年11月19日